

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-36

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（<u>券商策略会</u>）
活动参与人员（排名不分先后）	招商证券、大成基金、汇添富基金、中银国际证券、国泰海通资管、长城基金、上银基金、红土创新基金、运舟资本、姚泾河投资、长信基金、光大资管、华源证券、信达澳亚基金、人保养老、盘京投资、申万菱信基金、国盛证券、中信建投、国泰基金、天风证券、东方财富证券、南土资产、珠海横琴长乐汇资管、硕丰基金、中银理财
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2025 年 11 月 4 日-6 日
地点	网络及电话会议、招商证券策略会
形式	网络及电话会议、实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍 2025 年三季度综合毛利率环比变化情况。 2025 年第三季度，公司综合毛利率环比有一定改善，主要得益于存储类封装基板需求增加，封装基板产能利用率提升，广州广芯工厂爬坡稳步推进，使得封装基板营收规模增长、毛利率改善显著；同时，PCB 数据中心、有线通信业务收入持续增长，毛利率略有提升。上述因素共同助力公司综合毛利率的提升。 Q2、请介绍 2025 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。 公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025 年第三季度，数据中心、有线通信业务收入持续增长，各业务领域占比与上半年基本一致。

Q3、请介绍 2025 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2025 年第三季度，封装基板营业收入环比增加，各下游领域产品需求均有增长，其中存储类封装基板增长最为显著。

Q4、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。

公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，主要承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单。近期各类订单逐步投入生产，广州封装基板项目在 2025 年第三季度亏损逐步缩窄。

Q5、请介绍公司南通四期及泰国项目规划及当前建设进展。

公司新建工厂包括南通四期及泰国工厂，泰国工厂目前已连线试生产，南通四期在今年四季度连线。南通四期和泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设将助力 PCB 业务产能进一步释放。

Q6、请介绍公司 2025 年第三季度工厂产能利用率较第二季度变化情况。

公司综合产能利用率仍处于相对高位。2025 年三季度，PCB 业务总体产能利用率仍处于高位；封装基板业务因存储市场及应用处理器芯片类产品需求的增长，工厂产能利用率环比明显提升。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年三季度，受大宗商品价格变化影响，金盐、铜等部分原材料价格环比增长。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q8、请介绍公司 PCB 产品对 HDI 技术的应用情况。

	HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。 Q9、请介绍无锡新地块规划。 该地块为 PCB 业务算力相关产品的储备用地，预计分期投入，具体投资将根据业务发展和市场情况推进实施。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无